

6-102617-1 ✓ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU Headers

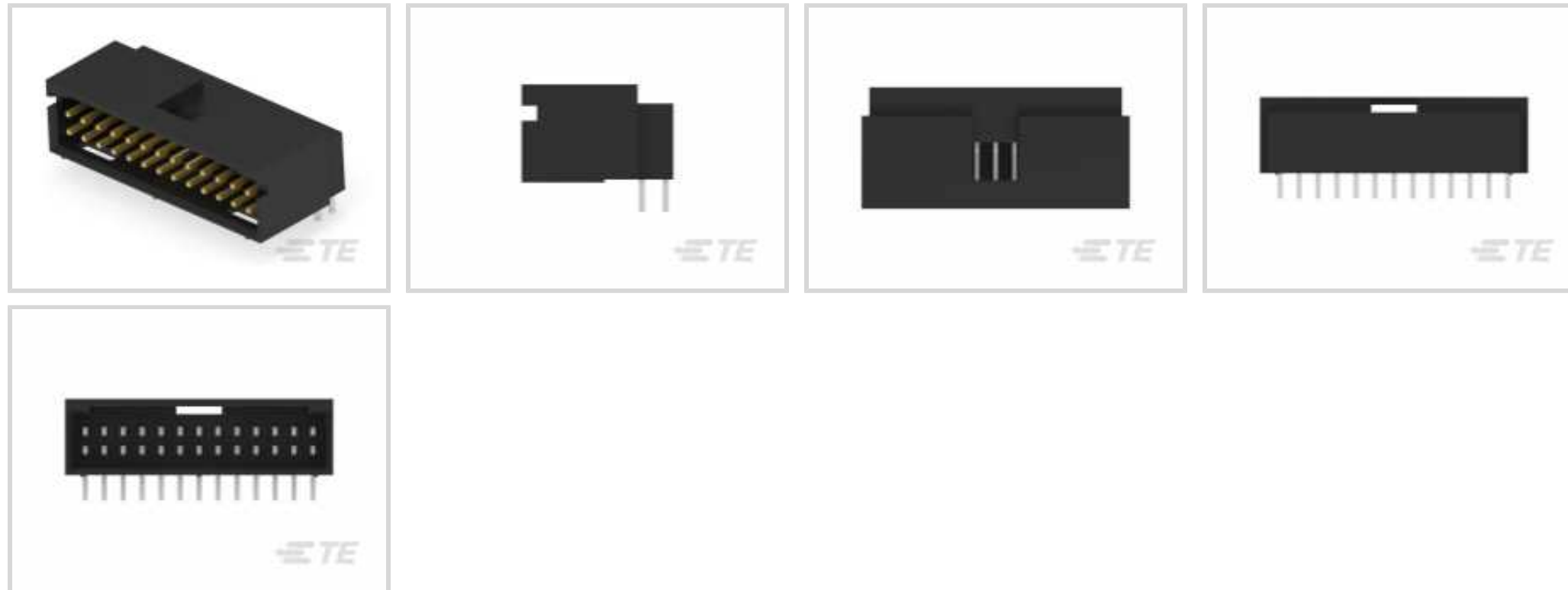
Interne TE-Nummer 6-102617-1

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board / Board-to-Board,
26 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold,
AMPMODU Headers

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Rechter Winkel**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **26**

Raster: **2.54 mm [.1 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anzahl von Positionen	26
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

Isolierwiderstand	5000 M Ω
Spannungsfestigkeit (max.)	750 Vrms

Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Standard
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Kontaktmerkmale

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	2.54 – 5.08 µm[100 – 200 µin]
Kontaktform	Quadratisch
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.381 µm[15 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.64 mm[.025 in]
Anschlussstift- und Restlänge	3.43 mm[.135 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötten

Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckarretierung	Arretierfenster
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Gegensteckarretierung	Mit
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	2.54 mm[.1 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.4 mm[.055 in]
Reihenabstand	2.54 mm[.1 in]

Verwendungsbedingungen

Gehäuseneintemperatur	Standard
Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Lötverfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

Behörde/Norm	CSA
Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	128
Verpackungs-Typ	Einsatz

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 ppm aus anderen Quellen
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 240 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

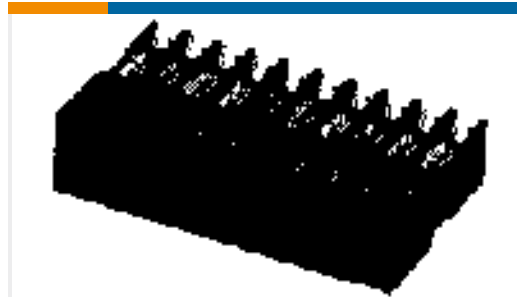
Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 1-534206-3
26 MODII VRT DR CE 100/115



TE Teilnr.: 1-102394-1
26 AMP MODU MT HSG DR .100CL

Auch serienmäßig | AMPMODU Headers



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(66)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (6117)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

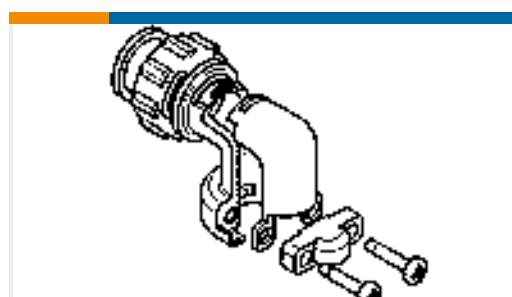
Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:208457-1
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28-24



TE Teilnr.:1676814-7
HSA5 240R 1%



TE Teilnr.:1546348-2
R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 13,CPC



TE Teilnr.:1-640445-3
13P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



Dokumente

Produktzeichnungen

26 MODII HDR DRRR SHRD LF

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_6-102617-1_J.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_6-102617-1_J.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_6-102617-1_J.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

Englisch